Surface Mount Fuse, 11 x 4.6 mm, Quick-Acting F, Telecom

IEC 60127-4 · 250 VAC · 250 VDC · Quick-Acting F

## Description
- Directly solderable on printed circuit boards

## Standards
- IEC 60127-4/2
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14
- Telcordia GR-1089
- UL 60950 / IEC 60950
- ITU-T K.20 and K.21
- TIA-968-A

## Approvals
- VDE Certificate Number: 106328
- UL File Number: E41599
- CSA File Number: 51172

## Applications
- xDSL and ADSL linecards and modems

## References
Packaging Details

## Weblinks
pdf-datasheet, html-datasheet, General Product Information, Approvals, CE declaration of conformity, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailed request for product

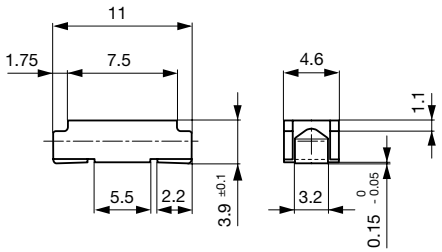
## Technical Data

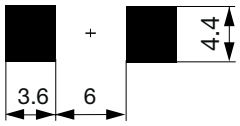
| | |
|---|---|
| Rated Voltage | 250 VAC, 250 VDC |
| Rated Current | 0.25 - 3.15 A |
| Breaking Capacity | 100 A |
| Characteristic | Quick-Acting F |
| Mounting | PCB,SMT |
| Admissible Ambient Air Temp. | -40 °C to 125 °C |
| Climatic Category | 40/085/21 acc. to IEC 60068-1 |
| Material: Housing | Thermoplastic, UL 94V-0 |
| Material: Terminals | Tin-Plated Copper Alloy |
| Unit Weight | 0.36 g |
| Storage Conditions | 0 °C to 60 °C, max. 70% r.h. |
| Product Marking | ⊟, Type, Current, Characteristic, Breaking Capacity, Approvals |

| | |
|---|---|
| Soldering Methods | Reflow, Wave |
| Solderability | 245 °C / 3 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td |
| Resistance to Soldering Heat | 260 °C / 10 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td |
| Current Carrying Capacity | acc. to EIA/IS-722, Test 4.3.3 |
| Load Humidity Test | MIL-STD-202, Method 103B<br>0.1 x In @ 0.85 r.H. @ 85°C |
| Moisture Resistance Test | MIL-STD-202, Method 106E<br>(50 cycles in a temp./mister chamber) |
| Terminal Strength | MIL-STD-202, Method 211A<br>Deflection of board 1 mm for 1 minute |
| Thermal Shock | MIL-STD-202, Method 107D<br>(200 air-to-air cycles from -55 to +125°C) |
| Case Resistance | acc. to EIA/IS-722, Test 4.7<br>>100 MΩ (between leeds and body) |
| Mechanical Shock | MIL-STD-202, Method 213B<br>(Shock 50gn, half sine wave, 11 ms) |
| Vibration, High Frequency | MIL-STD-202, Method 204D<br>Shock 20 gn, 20 min, 10-2 kHz, 12 cyc. |
| Resistance to Solvents | MIL-STD-202, Method 215A |
| Flammability | min. UL 94V-1<br>(acc. to EIA/IS-722, Test 4.12) |

## Dimensions

11 mm




Soldering pads

## Pre-Arcing Time

| Rated Current In | 1.25 x In min. | 2.0 x In max. | 10.0 x In min. | 10.0 x In max. |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 A - 3.15 A | 60 min | 120 s | 1 ms | 10 ms |

## Variants

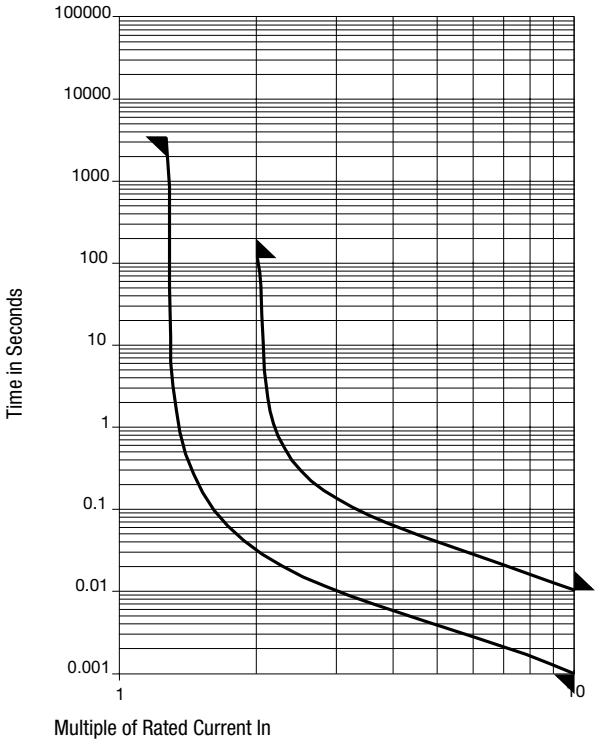
| Rated Current [A] | Rated Voltage [VAC] | Rated Voltage [VDC] | Voltage Drop 1.0 In typ. [mV] | Power Dissipation 1.25 $I_n$ typ. [mW] | Melting $I^2t$ 10.0 Intyp. [$A^2s$] | GR-1089-CORE [A] | UL60950 | ITU - Lightning Surge [A] | ITU - Power Induc- | ITU - Power Contact [A] | Order Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 250 | 250 | 1100 | 480 | 0.012 | < 1.9 | ● | 3.9 | | 100.0 | 2070.0010.xx |
| 0.315 | 250 | 250 | 1000 | 430 | 0.019 | < 1.9 | ● | 4.3 | ● | 100.0 | 2070.0011.xx |
| 0.4 | 250 | 250 | 230 | 190 | 0.02 | 3.1 | ● | 5 | ● | 100.0 | 2070.0012.xx |
| 0.5 | 250 | 250 | 190 | 190 | 0.03 | 5.1 | ● | 10 | ● | 100.0 | 2070.0013.xx |
| 0.63 | 250 | 250 | 170 | 230 | 0.07 | 9.2 | | 16 | ● | 100.0 | 2070.0014.xx |
| 0.8 | 250 | 250 | 200 | 330 | 0.12 | 13.15 | | 22 | ● | 100.0 | 2070.0015.xx |
| 1 | 250 | 250 | 170 | 390 | 0.23 | 13.15 | | 27 | ● | 100.0 | 2070.0016.xx |
| 1.25 | 250 | 250 | 150 | 390 | 0.47 | 13.15 | | 43 | ● | 100.0 | 2070.0017.xx |
| 1.6 | 250 | 250 | 150 | 490 | 0.84 | 13.15 | | 67 | ● | 100.0 | 2070.0018.xx |
| 2 | 250 | 250 | 140 | 600 | 1.4 | 13.15 | | 67 | ● | 100.0 | 2070.0019.xx |
| 2.5 | 250 | 250 | 130 | 670 | 2.6 | 13.15 | | 67 | ● | 100.0 | 2070.0020.xx |
| 3.15 | 250 | 250 | 130 | 870 | 4.8 | 13.15 | | 67 | ● | 100.0 | 2070.0021.xx |

1) 100 A @ 250 VAC/DC

## Packaging Unit

.xx = .11 Plastic Bag (100 pcs.)
.xx = .24 Blister Tape 33 cm Reel (2000 pcs.)

**[Kennlinien]**




16.03.2013

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9